

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-083

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司于2024年2月27日披露了《关于公司推动“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。现针对行动方案相关举措2026半年度进展情况说明如下：

一、深耕半导体存储行业，聚焦核心竞争力建设

公司聚焦存储产品的品质提升与产品创新，持续投入研发资源，在自研存储及主控芯片（含固件开发）、自有封测技术底座、新型AI端侧存储器设计、存储器周边技术、全球品牌建设，以及全球化运营能力等方面形成了有机组合的领先优势。公司依托长期积累形成的综合技术实力，形成丰富齐备的产品线，覆盖半导体存储器的各类应用场景，产品性能和品质获得各类应用场景的不同客户广泛认可。2026年半年度，公司实现营业收入240.88亿元，达上市以来同期营业收入的峰值，较上年同期同比增长136.26%。

未来，公司将坚定不移地聚焦主营业务，不断提升公司的市场影响力和核心竞争力，加强经营管理水平，增强公司的长期盈利能力。

二、坚持自主研发，以技术进步为牵引，通过产品竞争力落地大客户战略

公司高度重视自主研发，持续进行技术创新，努力把握市场需求和技术趋势，研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品。2026年上半年，公司研发投入为8.51亿元，较上年同期增长91.02%。

公司创新推出了全新的mSSD(Micro SSD)产品，通过SiP(System in Package)封装技术让SSD达到芯片级封装质量，不仅能够实现高效交付，还能灵活兼容M.2 2280、M.2 2242及M.2 2230等主流规格。为攻克小体积、高性能的散热痛

点，公司将 VC 相变液冷散热应用在 mSSD 上，设计出专属高效散热方案，根据公司内部测试，PCIe Gen5 mSSD 的高效散热方案将 11GB/s 峰值性能维持时间提升至 181 秒，连续读取容量可达 1991GB，是常规 PCBA SSD 散热方案的近 2.5 倍。随着端侧 AI 需求的全面爆发，mSSD 高度契合了 AI PC 对极致性能与紧凑形态的苛刻要求，公司也在积极将其向具身智能等高端应用场景拓展，提供高抗震/高可靠性的存储解决方案。截至本公告披露日，mSSD 已成功通过多家全球知名 PC 品牌厂商的认证，并实现规模化的量产导入。

报告期内，公司已经正式发布 AILPBGA，该产品采用自研技术标准与创新架构，单颗原生 256bit 位宽设计，带宽可达 307GB/s，容量覆盖 24GB~64GB，AILPBGA 对比标准 LPDDR5x，其位宽、性能、容量均高出数倍。AILPBGA 全面适配 LPDDR 标准接口，无需重构 SoC 和系统架构，大幅缩短终端研发与落地周期，有助于降低适配成本。AILPBGA 采用低功耗设计，不仅可大幅削减设备能耗，有效延长 AI 推理终端、边缘大模型设备续航时长。AILPBGA 采用 22×22mm 的 BGA1764 紧凑封装设计，体积小巧、集成度高，可灵活适配 AI 推理、中轻量模型部署等紧凑型终端。

报告期内，公司已发布 AIDIMM，该产品作为针对 AI 计算深度优化的内存，凭借最高 128GB 容量、256bit 位宽、307.2GB/s 超高带宽及紧凑体积，能有效解决当前智能体主机普遍存在的内存容量不足、算力任务卡顿、散热困难、升级不便等核心难题。该产品采用 4 颗 LPDDR5x 同面布局设计，布线简洁，搭载的高速率、高密度、高针脚数连接器可适配主流智能体主机的主板架构，无需对现有硬件进行大幅改造，从而降低客户硬件升级成本。AIDIMM 产品支持 0.9V-1.05V 动态调压，搭载 FDVFS 智能能效优化机制，可针对端侧 AI 推理、大模型运行等不同负载场景，智能调节电压与运行状态，实现 AI 负载下精细化动态功耗管理，有效提升端侧 AI 整体场景能效比，大幅降低整机运行发热，为 AI PC、智能体主机提供高性能、低功耗、易升级的 AI 内存解决方案，充分释放终端 AI 算力。

报告期内，公司发布了车规级 UFS 4.1 存储产品，该产品搭载自研 5nm 制程工艺高性能主控，顺序读取速度高达 4200MB/s，持续引领车规级存储产品创新。截至本报告发布之日，公司 mSSD 已成功通过多家全球知名 PC 品牌厂商的

认证，并实现规模化的量产导入。公司自研的 5nm 先进制程的 UFS 4.1 主控芯片凭借超越市场同类产品的卓越性能，与多家核心晶圆原厂达成深度的生态合作。

三、夯实公司治理结构，助力公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善并规范公司治理结构，建立健全内部控制体系和各项内部管理制度，构建权责明确、互相制衡、运作规范的公司法人治理结构。同时，规范公司及股东的权利义务，防止出现滥用股东权利、管理层优势地位等损害广大中小投资者利益的情形。

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 4 名独立董事，其人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的规定。董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，分别按照《公司章程》等有关规定在审计、发展战略规划与 ESG 战略规划、提名、薪酬与考核等方面协助董事会履行职能，为董事会的科学决策提供了科学和专业的意见和参考，为公司提高治理水平发挥了重要作用。

四、加强投资者沟通，提升信息披露质量

2026 年半年度，公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。报告期内，除定期报告和临时公告外，公司还披露了《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，公司将可持续发展理念作为企业战略的重要基石，致力于在公司治理、技术创新、绿色运营、员工发展、社会贡献等多个领域推进可持续发展，为行业进步和社会繁荣创造长期价值。

公司高度重视投资者关系维护，通过业绩说明会、接待机构调研、互动易、电话、邮箱等多种形式与投资者积极沟通，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。2026 年上半年，公司举办业绩说明会及投资者调研活动 33 场，通过互动易平台回答投资者问题 276 次，回复率 100%。

五、重视投资者合理回报，共享企业发展成果

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司于 2026 年 4 月 24 日、2026

年 5 月 19 日分别召开第三届董事会第十七次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度、2026 年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年其他中期分红方案的议案》，并于 2026 年 6 月 2 日实施完毕利润分配，本次利润分配由 2025 年度利润分配方案与 2026 年第一次中期利润分配方案共同构成，本次权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 1 日，每 10 股派发现金红利 9.907442 元（含税），详见公司于 2026 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度、2026 年第一次中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-065）。

未来，公司将继续根据所处发展阶段，立足实体，深耕主业，牢固树立回报股东意识，践行以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，增强市场信心，维护公司形象，共同促进资本市场积极健康发展。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日